

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

中电科芯片技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	浦银安盛基金、方正富邦基金、中邮人寿保险、问渠投资、中信建投资管、聚鸣投资、国华人寿保险、华富基金、中银基金、海富通基金、新华养老保险、中金基金、嘉实基金、华夏基金、敦和资管、太平资产管理、工银理财、兴全基金、天治基金、上海合道资产管理、银华基金、富荣基金、野村资管、长江证券、华安证券、九泰基金、上投摩根基金、光大保德信基金、东吴基金、宝盈基金、富安达基金、创金合信基金
时间	2024年6月24日 14:00-15:30
地点	电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 陈国斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>董事会秘书兼财务总监陈国斌先生向与会投资者介绍公司概况、重组过程、股东背景、公司业务优势及战略发展方向等内容。</p> <p>中电科芯片技术股份有限公司系上交所主板上市公司，注册地为重庆市，公司前身为中国嘉陵，先后经历2次重大资产重组，2021年底公司顺利完成第2次重大资产重组并融资9亿元，主营业务由锂离子储能电源变更为硅基模拟半导体。目前公司控股股东为中电科芯片技术（集团）有限公司（持股比例25.64%，电科系合计持股比例37.93%），实际控制人为国务院国资委。控股股东主要业务涵盖数字集成电路、模拟集成电路、微声电子、半导体</p>

光电子、传感器等芯片技术，主要围绕先进计算、5G 通信、汽车电子、智慧文博、智能传感等产业板块发展。

公司目前主要业务、产品为硅基模拟半导体相关芯片、器件、模组及整体解决方案和其相关的终端应用产品，主要包括射频前端、5G 通信、导航定位、卫星通信、电机驱动、电子开关等芯片、模组产品，可应用于物联网、绿色能源、安全电子、消费电子、汽车电子及智能电源等领域。公司下辖三家全资子公司，其中重庆地区 2 家，分别为重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司；深圳地区 1 家，为深圳市瑞晶实业有限公司。

2021 年之后，半导体行业进入下行周期，尤其是近两年来消费电子市场持续低迷、半导体产业内卷不断加剧、安全电子降价形势日趋严峻，行业跌价去库存、削减产能成为常态，行业及公司发展面临较大挑战。但随着人工智能、万物互联、低空经济及数字化转型等新兴产业发展，集成电路需求尤其是具备可持续供应特质的中高端芯片需求不断增长，为公司适时调整战略布局，优化产业及产品结构、推动国企思维向国家思维转变提供了契机。

公司重点布局物联网、绿色能源、汽车电子，并与安全电子形成“3+1”的未来重点产业路径。其中物联网所涉 5G 通信（基站）、卫星导航、卫星通信、短距离通信构成了公司在万物互联领域的业务基础，旨在通过打通室内——室外多种应用场景建立公司在物联网领域的产业链优势；绿色能源领域则通过 MOS 旁路光伏保护电路和模组的市场推广逐步满足大电流（25A 以上）应用场景的太阳能发电安全需求，为客户提供相对于肖特基二极管应用低发热、高过载、低正向压降指标的产品。目前该产品已推向市场，但尚处于市场开拓及培育期，公司业绩贡献和占比仍较小，目前正与国内头部客户开展洽谈合作；汽车电子领域，子公司瑞晶实业已通过 16949 车规级认证，公司电子开关芯片、导航芯片/模组、北斗短报文 SoC 芯片已成功导入国内某车企部分车型，尽管占公司整体销售占比较小，但标志着公司打通了汽车电子的市场通道，公司后续

将加快与国内主要车企的互动互联，推动公司更多产品（毫米波雷达芯片、电机驱动芯片、BMS、5G通信、短距离通信等）进入车企供应序列，为公司未来发展布局奠定基础。

在当前市场环境下，2024年公司针对子公司经营发展现状，继续坚持提前布局核心关键技术攻关，加快产品研制进度，重点开展“产业发展、管理提升、能力建设、上下协同”四项工作，推动子公司“聚焦、转型、升级”，即持续聚焦主责主业，瞄准主航道，策划拳头产品，重点布局未来产业，为公司发展提供持久的驱动力；推动公司产品及渠道从中低端向中高端转型，从红海向蓝海过渡；加快产线升级改造，升级瑞晶实业产线基础，打造模块和智能终端制造中心，形成公司产业协同。

二、互动交流主要内容

1、卫星通信领域的布局如何？北斗短报文产品应用领域是否满足公司未来发展需求？

答：随着航天技术和信息通信技术的不断演进，我国卫星通信事业实现飞速发展，其应用场景和综合能力在不断丰富和强化。如今，卫星通信已经进入新的演进阶段，随着商业化进程不断加速，其市场价值也在持续凸显。卫星通信技术不仅可为资源勘探、森林防火、抢险救灾、探险旅游、野生动物保护等应用场景提供有力支持，还能为深山、森林、沙漠、草原、戈壁等未被地面通信网络深度覆盖的地区送去“生命信号”，随着国家整体布局的逐步落实，相信相关领域的发展将会给行业及公司带来崭新的发展空间。卫星通信领域作为公司重点布局方向之一，相关产品涉及北斗短报文、窄带语音通信、宽带卫星互联网通信等应用场景。

其中北斗短报文通信是北斗系统相较于其他卫星导航系统的独特功能，传统应用需要在专用终端上实现，成本高、功耗高、体积大，北斗导航的推广应用受到限制，某种程度上，为普通民众提供应急通信服务的“痛点”，保障人民群众的应急安全，将北斗短

报文应用植入大众化移动终端（例如手机、智能穿戴等）成为产业界需尽快解决的核心问题。但通讯终端存在尺寸小、天线效率低、信号干扰强、电池容量有限、散热有限等局限，因此要求北斗短报文芯片在体积、功耗、接收灵敏度、发射效率等性能指标上达到极致水平。而一款射频基带一体化芯片需经历架构设计、原型验证、电路版图设计、仿真验证、物理验证、晶圆加工、芯片封装、测试验证、可靠性实验、用户验证、批量生产测试平台开发等流程，通常需要约 18~24 个月的时间。公司集中优势资源联合攻关、多种技术路线并行实施等方式，仅用不足 10 个月时间，突破了一系列关键技术，一次流片成功，圆满完成大众手机短报文芯片的研发、应用验证和量产，并在手机终端、智能手表、平板、汽车等领域实现应用。目前公司北斗短报文 SoC 芯片产品，在一粒芝麻大小（约 3.5 平方毫米）的芯片上，成功实现了大众手机与 3 万 6 千公里外的北斗卫星之间的超远距离通信。满足了大众手机对芯片性能、体积、功耗和成本的要求。目前公司正积极推动北斗短报文芯片产品拓展至其他主流手机和汽车厂商。

面向语音互联的第二阶段产品可支持窄带低数据量的传输，目前已完成流片，处于测试阶段，正积极推进在手机终端中实现搭载。第三阶段卫星互联网通信正在加快卫星网络建设，尚未形成组网批量供应状态，相关产品多波束赋型芯片尚待产业成熟后推广至终端应用。后续公司仍将加快研发和布局力度，适时推出相关产品应用，提前布局相关应用领域，为公司未来发展奠定基础。

如前所述，北斗短报文在多个领域具有广泛应用场景，包括但不限于手机、手表、平板、汽车以及特种领域（如地质监测、洋流监测等）。其中，地质监测等特种领域需要精准定位和即时信息传递，北斗短报文技术能够满足这些应用需求。目前，公司已经成功实现北斗短报文在汽车电子领域的应用通道，并积极开拓不同客户和应用领域。同时，由于终端客户需要获得相关授权，这一过程中可能存在不确定性，请投资者注意相关风险。

2、公司绿色能源板块如何布局？是否与光伏市场相关？

答：在绿色能源板块，公司提供的 MOS 光伏旁路保护开关电路和模块相较于传统肖特基二极管方案，具有低发热、高过载、低正向压降的特点，因此公司将基于以上特点面向大电流、高可靠、嵌入式应用需求用户提供差异化服务。

公司绿色能源板块产品涉及光伏旁路保护开关，目前已与行业头部客户开展洽谈合作并通过其技术论证。鉴于新产品尚处于市场导入阶段，经过前期市场和环境验证，该产品的整体表现基本符合应用端考量，后续将加强市场推广力度。我们认为，未来光伏市场将面临新增市场和存量市场升级迭代因素的双重影响，近年来相关市场发展有所放缓，但随着国家经济逐步回暖和公司市场开拓力度不断加强，相关产品仍具有较好市场前景。

3、公司后续资本运作计划如何？会整体注入控股股东资产吗？还是会继续向外谋求资产的重组并购？

答：资本运作是公司高质量发展的重要路径和手段之一。公司将按照既定的发展战略坚持对内强实力、对外谋发展的道路，在推动公司从国企思维向国家思维转变的同时，围绕做强做优做大的目标，统筹公司核心业务与资本运作，发挥好上市公司资本平台优势，全面提升整体效益，促进公司转型升级和高质量发展。对于重大事项公司将严格按照相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，请以公司信息披露为准。

4、公司将如何在汽车电子领域进行布局发展，目前有哪些产品分布以及进展如何？

答：公司正在积极布局汽车电子市场，包括卫星通信、车载导航、毫米波雷达等应用场景，公司会加快相关产品系列化开发及市场拓展。目前已有多家车企关注卫星通信功能，但车载卫星通信市场仍处于萌芽期，大规模应用还需要一定时间，后续公司会加快拓

展相关领域的市场渠道，推动相关业务成为公司新的业绩增长点。其中，北斗短报文模块在某头部车企实现供货，目前正积极导入其他知名车企；卫星及惯性组合导航模块实现供货；面向新能源汽车应用的 BMS 动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中；车规级低边电子开关芯片取得 AEC-Q100 认证，实现量产交付；全资子公司瑞晶实业已取得 16949 车规级认证，为公司未来在汽车电子领域的产业布局、产业协同奠定了坚实基础。

目前，公司北斗短报文、电子开关、北斗导航等产品已实现搭载，后续公司会继续保持与合作客户的交流合作，将更多产品推向市场，积极推动在汽车电子领域发展。

5、上市公司何时能具备实施分红条件，公司推动分红政策有什么具体举措？

答：公司前身中国嘉陵工业股份有限公司（集团），因其累计亏损导致公司未分配利润为负，不符合分红条件，导致公司重组至今未能通过分红回报投资者。公司高度重视股东回报，董事会及管理团队就分红事项专门开展内部讨论，一方面需要进一步加快新市场领域产业布局，在维持已有市场领域稳定发展的同时，加快新市场开拓力度，推动新技术、新产品的产业化进程，增强公司业务规模和盈利能力，尽快弥补以前年度亏损；另一方面，公司也会紧跟新《公司法》实施步伐，探讨子公司向母公司分红、资本公积弥补以前年度亏损等多种渠道，加快达到分红所需的各项条件，尽快实现股东分红回报。

6、2024 年全年业绩如何展望？

答：2024 年，公司将加大产品开发力度，依托现有物联网、绿色能源、汽车电子以及安全电子方面的技术和市场积累，不断提升芯片集成度和功耗控制水平，为未来多通道、高集成度、低能耗的竞争打下坚实基础；同时，公司持续推动产品链路门类的补充完

善，旨在为客户提供一揽子、一站式服务，增强客户粘性，降低客户供应商管理成本；公司将不断加强内部产业协同，共享三家子公司供应链、市场渠道、研发和管理等资源，降本增效，提升内部运营效率，降低运营成本；公司拟通过募集资金投资项目的实施，实现产品种类进一步完善、现有产能进一步提升，持续聚焦主营业务发展和核心技术创新，保持良好发展态势。

整体而言，在面临较大市场压力的同时，公司希望借助新市场、新领域、新产品的开拓/开发，推动公司产业及产品结构适时调整，助力公司业务稳定发展。

7、公司 5G 基站领域的应用及前景如何？

答：公司主要向国内主流客户提供 5G 基站芯片（射频前端模组 FEM、低噪声放大器、射频开关等）。移动通信领域在经历 2020-2022 年的 5G 投资高峰后，5G 基站投资放缓，受此影响基站设备制造商对射频集成电路的需求呈下降趋势，导致公司相关产品销量及占比下降。

随着国内经济逐步复苏以及新一代移动通信技术不断演进，5G 网络商业化部署不断推进，以及 5.5G 通感一体基站的商用落地，将进一步带动射频集成电路产业发展，射频器件需求或将随之增加，由此带来增量市场新装和存量市场升级迭代双重需求。

电科芯片是国内基站射频器件的重要供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作，公司产品系列较为完整，并持续推动新一代高隔离度、高线性、低噪声、小体积射频前端模组 FEM 产品迭代升级，产品系列可广泛应用于 4G、5G 基站设备中，并积极布局 5.5G 移动通信应用。

8、北斗短报文未来市场前景如何？

答：公司北斗短报文产品已初步打通手机、平板、手表、汽车及特殊领域的应用通道，给公司未来产业发展奠定了一定基础。但

考虑到相关产业目前尚处于培育发展期，相关行业标准、市场准入以及客户需求有待进一步夯实，请投资者注意风险。

从公司来看，北斗短报文相较语音通话功能的卫星通信芯片产品，日常使用成本较低（短报文短期内仍属免费试用，语音通话分钟成本相对较高），在车载、手机等应急通信场景中，具备较低的推广难度。公司相信，随着国家相关监管政策的完善和行业标准的统一，将会有更多友商进入该领域，相关市场才会出现快速发展态势，并推动该产品从概念级向标准级转变，从高端应用向中低端应用拓展。另一方面，公司也在不断对相关产品进行升级迭代，在产品的可靠性、集成度、功耗、信号传输效率等方面加大研发力度，确保公司维持核心竞争优势。与此同时，公司也在积极开拓新的手机厂商，加快推动相关产品的渗透率。

公司将以北斗短报文通信 SoC 芯片产品的成功量产与应用为契机，开展新一代北斗短报文通信、语音卫星通信和宽带卫星互联网通信等卫星通信系列化芯片产品研发，拓展手机终端、智能穿戴终端、卫星互联网终端、汽车电子、智能制造等市场领域，为公司发展提供更好的助力。

9、公司安全电子是否面临了较大的降价压力？

答：当前环境下，安全电子市场价格出现下滑，给行业产生一定压力。公司制定合理的定价政策，一方面积极开展降本增效持续降低降价因素带来的冲击和影响；另一方面不断提升产品的参数指标和集成度，为客户提供更优质高效的产品，通过产品技术升级提升自身盈利能力；公司根据市场变化适时调整产品结构，维持盈利水平在合理区间，减少外部市场冲击。

三、总结

芯片行业是国之重器，需要不断加大投入，但受产品验证及客户偏好影响，新产品推广及渗透往往需要较长时间。公司完成重大

	资产重组以来，持续加大研发投入，重点布局物联网、卫星通信、汽车电子等潜力产业，并对标国内外优质企业，把公司产品链路做大做全，增强公司抗风险能力。后续，公司将积极响应并紧跟国家战略布局步伐，针对未来战略新兴产业发展趋势，持续优化、完善公司中长期战略规划，以指导公司可持续发展。敬请投资者关注公司产业发展和经营实效，多提宝贵意见和建议，共同推动电科芯片的稳定、快速发展。
附件清单	无。
日期	2024年6月24日